

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan analisa hasil, dapat disimpulkan bahwa:

1. Waktu deposisi yang lebih lama menyebabkan massa CuPc yang terdeposisi pada permukaan QCM semakin besar, sehingga ketebalan, impedansi dan kekasaran lapisan relatif meningkat. Kekasaran lapisan CuPc yang lebih tinggi menunjukkan lapisan CuPc semakin bersifat hidrofobik.
2. Ketebalan optimal lapisan CuPc pada QCM terhadap respon kelembaban didapatkan pada pendeposisian CuPc selama 5 menit. Untuk ketebalan lapisan CuPc yang lebih tinggi respon kelembaban relatif meningkat, namun respon frekuensi turun pada ketebalan terbesar yang dapat dipengaruhi nilai impedansi yang tinggi.

5.2 Saran

Perlu dilakukan pengukuran ketebalan lapisan CuPC yang terbentuk di atas QCM menggunakan TMS. Serta perlu dilakukan pendeposisian lapisan CuPc dengan variasi waktu lebih dari 6 menit.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)